

삼성SDI, 2.3인치 LCD 모듈 개발

슬림기술 이용 두께 0.74mm 실현 ... 해상도 · 휘도 · 색재현율 우수

삼성SDI는 0.74mm의 두께로 세계에서 가장 얇은 2.3인치 LCD 모듈인 Ultimate Slim Module을 개발했다고 2월26일 발표했다.

최고의 슬림 기술을 통해 0.74mm의 두께를 실현한 것으로 기존 초박형 LCD 모듈의 두께 0.79mm보다 0.05mm 더 얇은 것이다.

삼성SDI는 회사가 보유한 첨단 기술인 Module Sliming 기술과 독자적인 금형 및 사출 기술을 이용한 LGP (Light Guide Panel) 가공기술 등을 적용해 얼티밋 슬림모듈 개발에 성공했다.

뿐만 아니라 슬림화에도 불구하고 얼티밋 슬림모듈은 320X240의 QVGA급 해상도와 300cd/m²의 휘도, 색재현율 70% 등의 우수한 성능을 갖추었고, 극한의 슬림화로 인해 발생할 수 있는 모듈의 강도 문제도 해결했으며, 슬림화로 야기될 수 있는 내구성 우려도 없었다고 강조했다.

삼성SDI는 신기술과 함께 슬림 모듈 양산기술도 확보해 2/4분기부터 1.29mm 두께의 Ultra Slim Module을 양산할 계획이다.

기존 양산제품의 두께 1.7mm보다 0.4mm 얇아 슬림 경쟁을 선도할 것으로 예상된다.

디스플레이 전문 조사기관인 디스플레이서치는 현재 13억2000만대 수준인 휴대전화 시장이 2010년까지 17억대로 성장할 것으로 전망하고 있다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2007/02/26>